



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 8

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	公端和弹射器配件
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	8
装载位置数量	8
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	8
行数	1



电源位置数量	8
--------	---

电气特征

工作电压	125 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	Y
PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	预镀锡
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
对接公端宽度	.7 mm[.028 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	直插式
端子接触部长度	3.6 mm[.142 in]
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	3.5 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.5 mm[.02 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.46 mm[.018 in]
端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	固定支脚



PCB 安装对准	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	2 mm[.079 in]
外壳材料	热塑性聚酯 GF

尺寸

连接器宽度	8 mm[.315 in]
PCB 厚度（建议）	1 – 1.6 mm[.039 – .063 in]
连接器高度	12.45 mm[.49 in]
连接器长度	18.6 mm[.732 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

UL 等级	已认证
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	25
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



文档

产品图纸

D1100S HDR ASSY, 8POS,Y-KEY, V, AU-PL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2394617-8_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2394617-8_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

2-2394617-8

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 8 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Header & Ejector Assembly, Gold (Au), Through Hole - Solder, Power



[ENG_CVM_CVM_2-2394617-8_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。